

產品摘要:

TIS™580-12 系列是一种单组份脱醇型室温固化导热硅胶，具有对电子器件冷却和粘接功效。可在短时间内固化成硬度较高的弹性体。固化后与其接触表面紧密贴合以降低热阻，从而有利于热源与其周围的散热片、主板、金属壳及外壳的热传导。本系列产品具有导热性能高、绝缘性能好以及便于使用等优点，本产品对包括铜、铝、不锈钢等金属有良好的粘接性，固化形式为脱醇型，对金属和非金属表面不产生腐蚀。

特性

- 》良好的熱傳導率：1.2W/mK
- 》良好的操作性，粘著性能
- 》較低的收縮率
- 》較低的粘度，降低氣孔產生
- 》良好的耐溶劑、防水性能
- 》較長的工作時間
- 》優良的耐熱沖擊性能

應用:

广泛应用是代替导热硅脂（膏）及导热胶垫作LED铝基板与散热器、大功率电器模块与散热器之间的填充粘接、散热。用此胶后可以除掉传统的用卡片和螺钉的连接方式，带来的结果是更可靠的填充散热、更简单的工艺、更经济的成本。

如：可广泛用于个人便携式电脑的集成电路、微机处理器、大功率LED、内存模块、高速缓冲存储器、密封的集成芯片、DC/AC 转换器、IGBT 及其它功率模块、半导体、继电器、整流器和变压器等的封装。

TIS™580-12 特性表		
外观	白色膏状	測試方法
相对密度 (g/cm ³ , 25°C)	1.2	ASTM D297
表干时间 (min, 25°C)	≤20	*****
固化类型 (单组份)	脱醇型	*****
粘度 @ 25°C 布氏(未固化)	5000 cps	ASTM D1084
完全固化时间 (d, 25°C)	3-7	*****
抗張強度 (psi)	≥ 150	ASTM D412
硬度 (Shore A)	25	ASTM D2240
剪切强度 (MPa)	≥ 2.0	ASTM D1876
剥离强度 (N/mm)	> 3.5	ASTM D1876
使用温度范围 (°C)	-60~250	*****
体积电阻率 (Ω·cm)	2.0×10 ¹⁶	ASTM D257
介电强度 (KV/mm)	10	ASTM D149
介电常数 (1.2MHz)	2.9	ASTM D150
导热系数 W/(m·K)	1.2	ASTM D5470
阻燃性	UL94 V-0	E331100

使用说明

- 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、施 胶：拧开胶管盖帽，先用盖帽尖端刺破封口，将胶液挤到已清理干净的表面，进行涂覆或灌注。
- 3、固 化：将涂装好的部件置于空气中会有慢慢结皮的现象发生，任何操作都应该在表面结皮之前完成。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度，如果部位位置较深，尤其是在不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长，如果温度较低，固化时间也将延长。
- 4、操作好的部件在没有达到足够的强度之前不要移动、使用或包装。

注意事项

- 1、操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能。
- 2、本产品固化过程中会释放少量的副产物，对皮肤和眼睛有轻微刺激作用，建议在通风良好处使用。
- 3、远离儿童存放。
- 4、若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗；若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗并到医院检查。

包装规格

100ml/支, 100支/箱; 300ml/支, 24支/箱。

贮存及运输

- 1、在阴凉干燥处贮存，贮存期：6个月（25°C）。
- 2、本产品属于非危险品，可按一般化学品运输